

## IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



## シングルペアイーサネット PCB ソケット

シングルペアイーサネットは、データと電力を伝送するために必要な配線ペアが1つだけの技術です。その結果、SPEはフィールドレベル以上のネットワークとして推奨されるようになることが期待されます。シングルペアイーサネット（SPE）の利点は次の通りです：

- 整合性：シングルペアイーサネット（SPE）により、センサーからクラウドへのラウドまでイーサネットベースの統一された通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新的：軽量化、省スペース化、設置工数の削減。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8 PCBインサート, ソケットコネクタ, はんだ接続, オス接点, IP67 (ハウジングあり), THT/THRはんだ接続, 180°, 極数: 2
注文番号	<a href="#">2735920000</a>
種別	IE-PCB-SPM-P-180-THR
GTIN (EAN)	4050118820164
数量	100 Stück

## IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	14.5 mm	奥行き (インチ)	0.571 inch
高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.945 inch
幅	10.1 mm	幅 (インチ)	0.398 inch
正味重量	3 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

## システム仕様

PCB の取り付け	はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動 はんだ付け, フローはんだ 付け
カテゴリー	THT/THRはんだ接続	
保護度合い	T1-B	プラグイン回数
性能カテゴリー	IP67 (ハウジングあり)	≥ 100
極数	2	外向きエルボ
		180°
		接続方式
		はんだ接続, オス接点
		製品ファミリー
		産業用イーサネット

## 標準

コネクタ規格	IEC 63171-5
--------	-------------

## 電気プロパティ

定格電圧	72 V	定格電流	4 A
絶縁耐性	≥ 500 MΩ	耐電圧、接点 / シールド	2250 V DC
耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC		

## 材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	Ni/Au
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

## 梱包

VPE 長	330 mm	VPE幅	330 mm
VPEの高さ	49 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/02 5:44:33 CEST

## IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

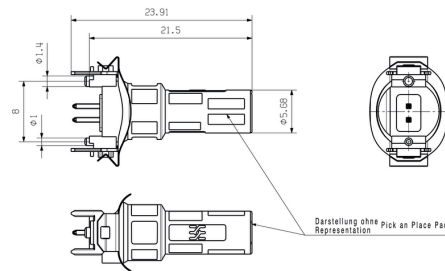
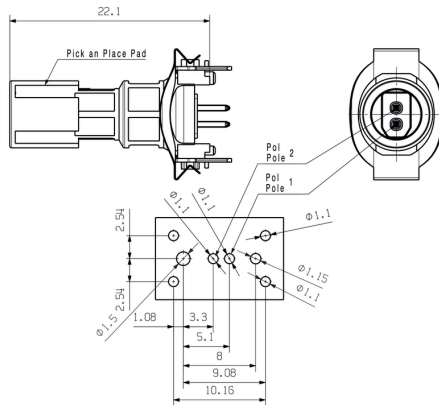
[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PCB-SPM-P-180-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.